

BEST AVAILABLE COPY
Doc Ref. FPI
Appl. No. 09/849,537

Heat sink for plastic ball grid array on IC chip surface has antioxidant coating on protruding body mounted on chip surface to form an elastic connecting structure using material adhesion

Patent number: FR2803098
Publication date: 2001-06-29
Inventor: WHIEH WEN LE
Applicant: ORIENT SEMICONDUCTOR ELECT LTD (TW)
Classification:
- international: H01L23/367; H01L23/433; H01L23/498; H01L23/34; H01L23/48; (IPC1-7): H01L23/367
- european: H01L23/367W; H01L23/433E; H01L23/498C4
Application number: FR19990016320 19991223
Priority number(s): FR19990016320 19991223; DE19992022576U 19991222

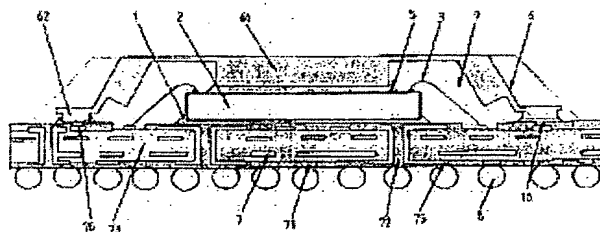
Also published as:

DE29922576U (U1)

Report a data error here

Abstract of **FR2803098**

The heat sink has a protruding body on its inside, a coating of antioxidant deposited on the protruding body, a substrate with an earth connection point connected to a heat sink connection finger, a silver adhesive connecting the chip to the substrate and heated to mount the chip on the substrate and an elastic, heat-conducting adhesive deposited onto the surface of the protruding body or chip. The protruding body is connected to the chip surface using a joining arrangement and is mounted on the chip surface to form an elastic connecting body structure using a material adhesive process.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 803 098

②1 N° d'enregistrement national : **99 16320**

⑤1 Int Cl⁷ : H 01 L 23/367

⑫

DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITE

A3

②2 Date de dépôt : 23.12.99.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 29.06.01 Bulletin 01/26.

⑤6 Les certificats d'utilité ne sont pas soumis à la
procédure de rapport de recherche.

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : *ORIENT SEMICONDUCTOR ELEC-
TRONICS LTD — TW.*

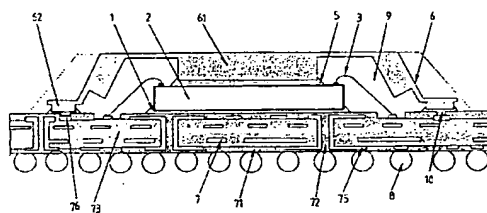
⑦2 Inventeur(s) : *WHIEH WEN LE.*

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire(s) : *CASALONGA ET JOSSE.*

⑤4 **TAMPON THERMIQUE POUR PUCE DE CIRCUIT INTEGRE.**

⑤7 Le tampon thermique (6) de la présente invention est un tampon thermique d'une matrice de billes en plastique à la surface d'une puce (2) de circuit intégré. Il comprend un corps saillant (61) sur son côté intérieur, une couche d'antioxydant appliquée sur le corps saillant (61), un substrat (7) comportant un point (76) de connexion à la masse connecté à un doigt de câblage (62) du tampon thermique, une colle à l'argent (1) reliant la puce (2) et le substrat (7), un adhésif thermoconducteur élastique (5) appliqué sur la surface du corps saillant (61) ou la surface de la puce (2), le corps saillant (61) étant câblé avec la surface de la puce (2) en utilisant un dispositif de câblage.



FR 2 803 098 - A3



Tampon thermique pour puce de circuit intégré

La technique PBGA ("Plastic Ball Grid Array", matrice de billes en plastique) est une technique d'encapsulation de circuits intégrés. Dans la structure de PBGA, une grande quantité de chaleur est facilement dégagée quand le composant fonctionne. Le tampon thermique exposé classique des produits PBGA comporte une structure de section épaisse. Lorsqu'un tampon thermique exposé est ajouté à l'intérieur du produit PBGA, un corps d'isolation en résine synthétique de couleur noire est prévu entre le tampon thermique et la surface de la puce. Ainsi, le chemin de transfert thermique de la chaleur dégagée par la surface de la puce passe à travers une couche de corps en caoutchouc synthétique relativement épaisse (l'épaisseur étant le double de celle de la puce) afin de transmettre la chaleur provenant de l'intérieur du PBGA au tampon thermique et de la dissiper.

Le corps en caoutchouc de résine synthétique n'étant pas un bon conducteur, l'effet du transfert de chaleur est inférieur à celui du stockage de chaleur. Ainsi, ceci provoque le stockage de l'énergie thermique à l'intérieur du corps en résine synthétique.

Cependant, les fonctions des puces sont sans cesse améliorées et la quantité de chaleur produite pendant le fonctionnement des composants augmente. L'épaisseur du tampon thermique exposé classique est constante, et une distance le sépare de la puce (comme montré en figure 1). Ainsi, l'efficacité de la dissipation thermique est limitée et devrait être améliorée.

La présente invention propose un tampon thermique d'une matrice de billes en plastique à la surface d'une puce. Ce tampon com-

prend un corps saillant sur son côté intérieur, une couche d'anti-oxydant appliquée sur le corps saillant, un substrat comportant un point de connexion à la masse connecté à un doigt de câblage du tampon thermique, une colle à l'argent reliant la puce et le substrat, la colle à l'argent étant chauffée pour durcir pour monter la puce sur le substrat, un
5 adhésif thermoconducteur élastique appliqué sur la surface du corps saillant ou la surface de la puce, le corps saillant étant câblé avec la surface de la puce en utilisant un dispositif de câblage, et le corps saillant étant monté sur la surface de la puce pour former une structure
10 de corps de câblage élastique en utilisant un procédé de collage de matériau.

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description détaillée suivante, faite en référence aux dessins d'accompagnement dans lesquels :

15 la figure 1 est une vue schématique d'un tampon thermique exposé classique d'une matrice de billes en plastique;

la figure 2 représente une matrice de billes en plastique comportant un tampon thermique selon la présente invention;

20 la figure 3 est une vue schématique illustrant la connexion du corps saillant du tampon thermique et de la puce selon la présente invention.

Les figures 2 et 3 représentent une structure de tampon thermique 6 d'une matrice de billes en plastique (PBGA) selon la présente invention montée à la surface d'une puce.

25 Selon la présente invention, le tampon thermique 6 est monté au sommet de la puce 2 et du substrat 7, et recouvre toute la puce 2. A un certain emplacement sur le tampon thermique 6, en correspondance avec la puce 2, est prévu un corps saillant 61. Une région de doigt de câblage soudé est prévue, ainsi qu'une saillie 64 afin d'accroître le volume du tampon thermique 6.
30

Sur la figure 3 est représentée l'adhésion entre le tampon thermique 6 du substrat PBGA 7 et la surface de la puce 2. Les éléments essentiels de la présente structure sont le substrat 7, la puce 2, et le tampon 6.

35 La couche intérieure du tampon thermique 6 (excepté le corps

saillant 61) est dotée d'une couche plaquée 63 par galvanoplastie ou par électrodéposition pour prévenir l'oxydation de surface du tampon thermique 6. Si la couche plaquée 63 est une surface en résine de polymère, elle a l'effet d'un courant anti-statique. Entre le corps saillant 61 du tampon thermique 6 et la puce 2, la surface de celle-ci est revêtue d'une couche anti-oxydante 11 pour empêcher l'oxydation de la couche de surface du corps saillant 61 dans le procédé de fabrication, qui provoque un phénomène de dénudage avec un agent adhésif thermoconducteur 5. L'agent adhésif thermoconducteur 5 subit un traitement de durcissement dans une pièce chauffante pour former une couche adhésive flexible. Ainsi, non seulement le tampon thermique peut être monté sur la surface de la puce 2, mais il possède aussi une résistance contre la contrainte résultant des variations de température.

En référence à la figure 2, le procédé de montage du tampon thermique 6 sur la surface de la puce 2 comprend les étapes consistant à :

(a) obtenir un tampon thermique 6 présentant une taille qui peut s'adapter à la puce 2 et à la taille d'une région de câblage soudé 4, le côté intérieur du tampon 6 étant pourvu d'un corps saillant 61 et d'une saillie 64;

(b) disposer une couche d'anti-oxydant 11 à la surface du corps saillant 61 collé à la surface de la puce 2 et au tampon thermique 6;

(c) prévoir un substrat PBGA 7 pour correspondre avec un doigt de câblage du tampon thermique 6 de manière telle qu'un point 76 de connexion à la masse de la surface 7 est connecté au doigt de câblage 62 du tampon thermique 6;

(d) relier la puce 2 et le substrat 7 en utilisant une colle à l'argent 1, la colle à l'argent 1 étant chauffée pour durcir pour monter la puce sur le substrat;

(e) enduire la surface du corps saillant 61 ou la surface de la puce 2 d'un adhésif thermoconducteur élastique 5;

(f) câbler le corps saillant 61 du tampon thermique 6 avec la surface de la puce 2 en utilisant un dispositif de câblage; et connecter

le doigt de câblage 62 du tampon thermique 6 au point 76 de connexion à la masse du substrat 7; et

5 (g) monter le corps saillant 61 sur la surface de la puce 2 pour former une structure de corps de câblage élastique en utilisant un procédé de collage de matériau.

Dans un autre mode de réalisation préféré de la présente invention, le tampon thermique 6 est situé très près de la puce 2, en laissant un espace suffisant pour réaliser un revêtement en résine synthétique pour apporter l'écoulement en douceur de la résine. Il n'y a donc
10 pas d'autre adhésif entre le corps saillant 61 et la surface de la puce 2.

REVENDICATION

1. Tampon thermique (6) d'une matrice de billes en plastique à la surface d'une puce (2), caractérisé en ce qu'il comprend :
- un corps saillant (61) sur son côté intérieur;
 - une couche d'anti-oxydant (11) appliquée sur le corps saillant (61);
 - un substrat (7) comportant un point (76) de connexion à la masse connecté à un doigt de câblage (62) du tampon thermique (6);
 - une colle à l'argent (1) reliant la puce (2) et le substrat (7), la colle à l'argent (1) étant chauffée pour durcir pour monter la puce (2) sur le substrat (7);
 - un adhésif thermoconducteur élastique (5) appliqué sur la surface du corps saillant (61) ou la surface de la puce (2);
 - le corps saillant (61) étant câblé avec la surface de la puce (2) en utilisant un dispositif de câblage; et
 - le corps saillant (61) étant monté sur la surface de la puce (2) pour former une structure de corps de câblage élastique en utilisant un procédé de collage de matériau.

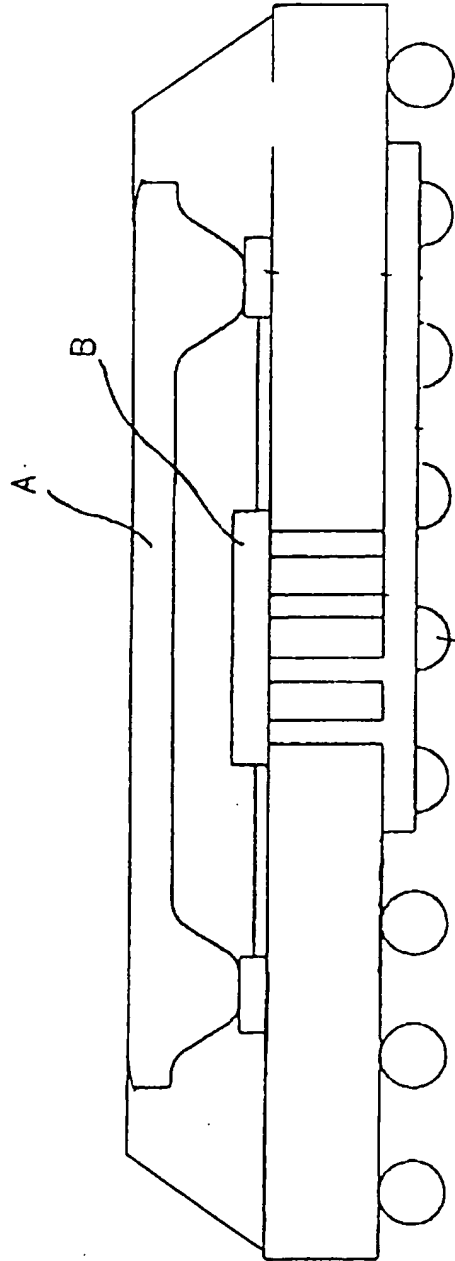


FIG. 1

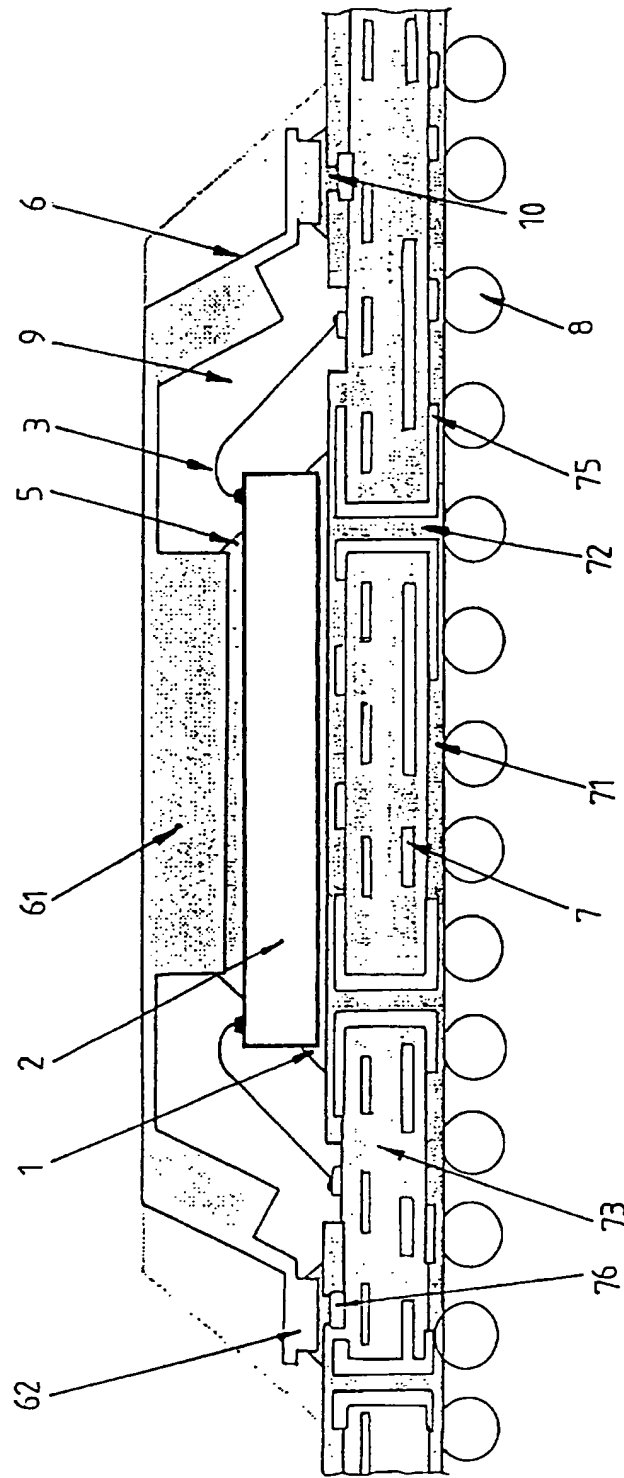


FIG. 2

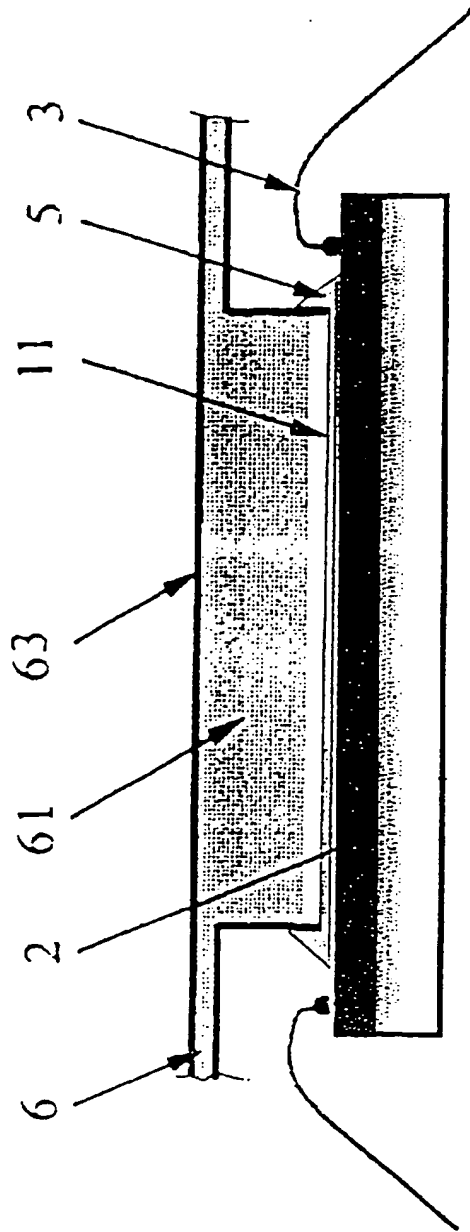


FIG. 3

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.